

证券代码：603936
2025-071

证券简称：博敏电子

公告编号：

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	深圳市博敏电子有限公司（以下简称“深圳博敏”）
	本次担保金额	5,000 万元
	实际为其提供的担保余额	11,950 万元（不含本次）
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用： _____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用： _____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	327,402.28
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	76.86
特别风险提示（如有请勾选）	☒ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% ☐ 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☐ 本次对资产负债率超过 70% 的单位提供担保
其他风险提示（如有）	不适用

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足日常经营及业务发展资金需求，深圳博敏向中国银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称“中国银行”）申请授信额度为人民币 5,000 万元，期限为自 2025 年 9 月 4 日至 2025 年 12 月 30 日，博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）在前述授信额度内为深圳博敏提供连带责任保证担保并于 2025 年 9 月 4 日与中国银行签署了《最高额保证合同》。前述担保不存在反担保情况。

（二）内部决策程序

公司分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 23 日召开第五届董事会第十九次会议、2024 年年度股东大会审议通过《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》，为保证公司及子公司向业务合作方申请授信或其他经营业务的顺利开展，同意公司 2025 年度为子公司及子公司之间就上述综合授信额度内的融资提供合计不超过 22.50 亿元新增的担保额度（其中为下属资产负债率 70%以上的子公司提供新增担保不超过人民币 18.50 亿元，为下属资产负债率 70%以下的子公司提供新增担保不超过人民币 4 亿元），担保期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会审议新的对外担保额度预计之日止，在上述授权期限内，担保额度可循环使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：临 2025-034）、《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：临 2025-036）和 2025 年 5 月 24 日披露的《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2025-046）。

本次担保前，公司为深圳博敏已实际提供的担保余额为人民币 11,950 万元；本次担保后，在上述股东大会审议担保额度及有效期内，公司可为深圳博敏提供的新增担保额度为人民币 42,000 万元。

本次新增担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	深圳市博敏电子有限公司
被担保人类型及上市公	☐ 全资子公司

司持股情况	☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	博敏电子股份有限公司 98.8703%、深圳市博芯联创投资合伙企业（有限合伙） 1.1297%		
法定代表人	王强		
统一社会信用代码	91440300279454287J		
成立时间	1994 年 5 月 24 日		
注册地	深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区龙王庙工业区 23 栋 101、21 栋、22 栋、23 栋		
注册资本	23,060.5252 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	自动化设备软、硬件及应用系统的设计、开发、销售、服务；计算机软、硬件、电子电路系统、电子部件及整机、印制电路板、图像处理和信号处理系统及模块、薄膜混合集成电路的设计、研发、销售与技术服务；印制电路板元器件销售与技术服务；电子材料的研发、销售与技术服务；国内商业、物资供销业；经营进出口业务；设备租赁。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）电子部件及整机、印制电路板的制造；电子材料的制造；印制电路板元器件的贴装、封装。电子电路系统、电子部件及整机的制造；印制电路板的制造；印制电路板元器件的贴装、封装；电子材料的制造；电子电路系统、电子部件及整机、印制电路板、图像处理和信号处理系统及模块、薄膜混合集成电路、电子材料的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	71,843.54	72,288.36
	负债总额	48,060.47	83,094.01
	资产净额	23,783.07	-11,306.34
	营业收入	27,819.86	49,553.42
	净利润	-2,796.11	-13,551.61

三、担保协议的主要内容

担保金额：人民币 5,000 万元

保证方式：连带责任保证担保

保证期间：合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并按或分别要求保证人承担保证责任。

保证范围：合同所担保债权之最高本金余额为人民币 5,000 万元，主债权发生期间届满之日，被确定属于合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。依据上述确定的债权金额之和，即为合同所担保的最高债权额。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为了满足深圳博敏日常经营和业务发展过程中的资金需求，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。同时有利于子公司业务的开展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具备必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为：此次担保是为满足深圳博敏在经营过程中的资金需要，被担保方为公司控股子公司，深圳博敏经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控，不会损害上市公司及公司股东的利益。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。因此，同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 327,402.28 万元（均系公司为子公司以及子公司之间提供的担保，不存在为其他第三方提供担保的情形），占公司最近一期经审计净资产的 76.86%（不含本次担保）。目前公司及子公司对外担保的在保余额为 121,292.98 万元（不含本次担保）。

备注：担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。公司未对控股股东和实际控制人

及其关联方提供担保。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2025 年 9 月 5 日